



# PRODUKTENTWICKLUNG: EINE OPTIMALE GEHÄUSE- UND KÜHLLÖSUNG FÜR DEN COMPACT INDUSTRIE PC VON JANZ TEC.

## SCHROFF'S INTERSCALE PLATTFORM IM EINSATZ ALS INDUSTRIE PC.

Während die Prozessorleistung stetig steigt, werden Systeme immer kleiner. Mit der Datenverarbeitungskapazität eines Systems nehmen die Leistungsaufnahme und folglich auch die entstehende Wärme zu. Empfindliche elektronische Bauelemente erfordern eine entsprechende Kühlung für einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb.

Die konfigurierbare **Interscale Plattform** mit seinem

- flexiblen Gehäusedesign
- samt integrierten EMV Schutz,
- seiner patentierten Kühllösung, dem flexiblen Wärmeleitkörper (Flexible Heat Conductor, FHC)
- in Kombination mit dem im Gehäuse integrierten Kühlkörper



bilden die optimale Lösung für den Mini | Compact Industrie PC „FALCON passive 2“ von Janz Tec, ausgestattet mit Mini-ITX Mainboards!

AAEON liefert die Mini-ITX Mainboards für diese Mini | Compact Industrie PCs. Diese unterstützen die neuesten Intel® Prozessoren Generationen bis zur Core™ i7-Reihe. Damit gibt es genügend Leistungsreserven auch für anspruchsvollste Aufgaben der Industrie-Automation oder Robotik-Anwendungen.



## INTERSCALE GEHÄUSE

Pentair hat die konduktionsgekühlten **SCHROFF Interscale Gehäuse** speziell für Elektronik mit kleinem Formfaktor entwickelt. Entsprechend sind diese mit unserem patentierten flexiblen Wärmeleitkörper kompatibel und decken mit dem im Gehäuse integrierten Kühlkörper unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der Wärmeabfuhr ab.

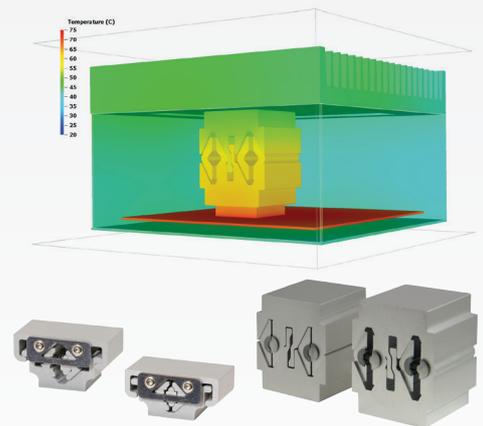
Interscale Gehäuse weisen zudem eine ausgeklügelte Verriegelungskonstruktion mit Laschen auf, die für einen integrierten EMV-Schutz von 20 dB bei 2 GHz sorgt und eine Schutzart bis IP 30 gewährleistet. Notwendige Ausbrüche und das Corporate Design sind kundenindividuell umsetzbar. Sprechen Sie uns für Ihre individuelle Gehäuselösung an.

## FLEXIBLER WÄRMELEITKÖRPER (Flexible Heat Conductor, FHC)

Der **flexible Wärmeleitkörper** bietet durch seine patentierte Konstruktion eine branchenweit unerreichte Performance im Bereich der Konduktionskühlung für Elektronik mit kleinem Formfaktor.

Ausgestattet mit Federn erlaubt es ein vertikales Ausdehnen und Zusammenziehen des Aluminiumblocks. Aufgrund des innovativen Designs kann sich der flexible Wärmeleitkörper nach Bedarf anpassen und so einen optimalen Oberflächenkontakt zwischen den Passflächen gewährleisten, was zu einem geringeren Wärmewiderstand führt. Somit wird die als Wärme auftretende Verlustleistung der Prozessoren über einen durchgehenden Wärmepfad zum Gehäuse optimal abgeführt ohne die Notwendigkeit eines Wärmeleitpads.

Flexible Wärmeleitkörper sind in zwei Standardgrößen erhältlich, die nach ihrer jeweiligen Größe als 20mm bzw. 70mm Wärmeleitkörper bezeichnet werden.



	Flexibler 20 mm-Wärmeleitkörper	Flexibler 70 mm-Wärmeleitkörper
Größe (L x B x H)	22 mm x 22 mm x 19,75 mm	50 mm x 50 mm x 68,5 mm
Abgedeckter Toleranzbereich	1,5 mm	2,5 mm
Prozessorompatibilität	Intel-, AMD-, Via-, Freescale-, Nvidia- und Texas-Instruments-Prozessoren mit BGA-Sockel	ATX-/ITX-/Mini-ITX- und COM-Systeme mit Intel Core i-Prozessoren mit den folgenden Sockeln: • Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 • AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)
Empfohlene Befestigung	Wärmeleitendes Klebeband	Rahmen und Winkel
Maximale Verriegelungskraft des Deckels mit Kühlkörper	60 N	120 N